

532433-8 ✓ 有效

AMP-HDI

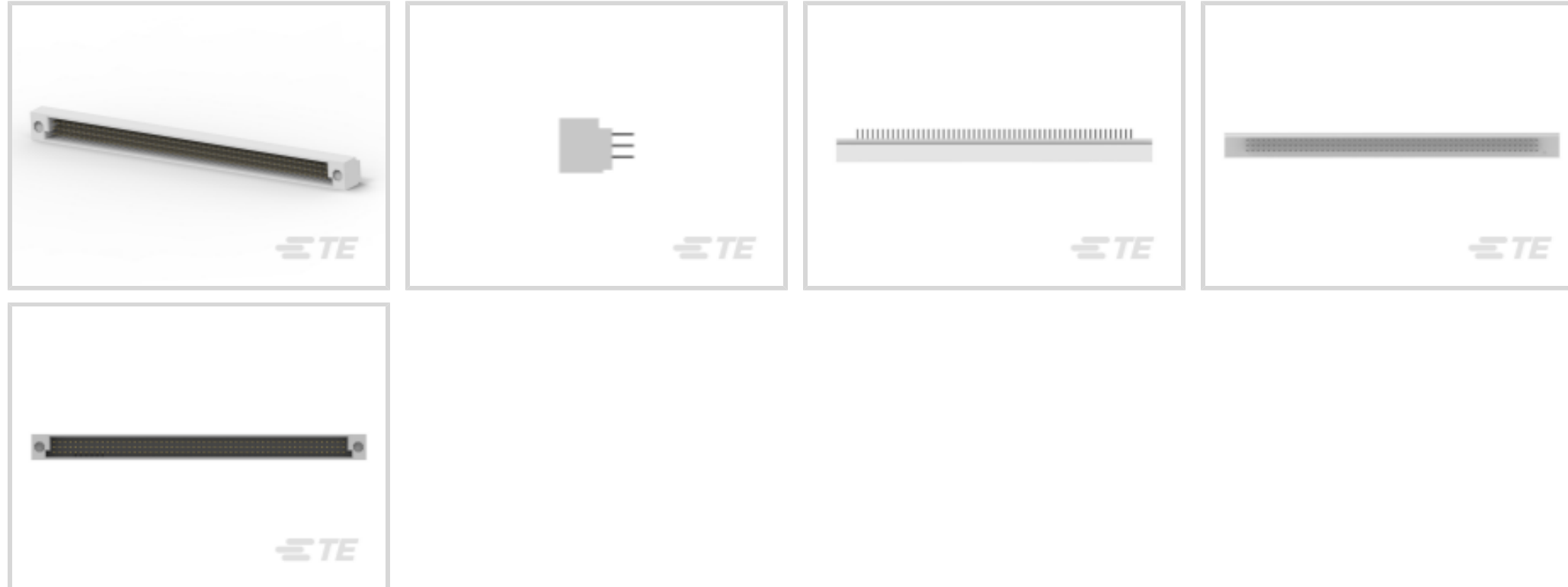
TE 内部编号 532433-8

PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 165 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Fully Shrouded, Gold, Through Hole - Solder, Signal, Black, Tube

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



连接器系统: 板对板

位数: 165

行数: 3

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装方向: 垂直

产品特性

产品类型特性

| | |
|-------------|----------|
| 连接器系统 | 板对板 |
| 接头类型 | 全部带罩 |
| 可密封 | 否 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| PCB 连接器组件类型 | PCB 安装接头 |

结构特性

| | |
|----------|-----|
| 可堆叠 | 否 |
| 位数 | 165 |
| 行数 | 3 |
| PCB 安装方向 | 垂直 |

电气特征

| | |
|------|------|
| 绝缘电阻 | 3 MΩ |
|------|------|

主体特性

| | |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

接触件特性

| | |
|----------------|--------------------------|
| 端子接触部长度 | 5.33 mm |
| 接合方柱尺寸 | .64 mm[.025 in] |
| 端子布局 | 矩阵 |
| 端子接合区域电镀材料厚度 | .76 μ m[30 μ in] |
| 端子形状和构造 | 四梁 |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡 |
| 端子基材 | 磷青铜 |
| 端子接触部电镀材料 | 金 |
| 端子类型 | 插针 |
| 端子额定电流 (最大值) | 3 A |

端接特性

| | |
|-------------|-----------------|
| 方形端接柱体和尾部尺寸 | .64 mm[.025 in] |
| 端接柱体和尾部长度的 | 4.83 mm[.19 in] |
| PCB 端接方法 | 通孔 - 焊接 |

机械附件

| | |
|----------|-----|
| 接合对准类型 | 键控 |
| 连接器安装类型 | 板安装 |
| 接合对准 | 不带 |
| PCB 安装对准 | 不带 |
| PCB 安装固定 | 不带 |

壳体特性

| | |
|----------|----------------|
| 外壳材料 | 热塑性 |
| 中心线 (间距) | 2.54 mm[.1 in] |

尺寸

| | |
|-------------|------------------|
| 连接器高度 | 11.73 mm[.46 in] |
| PCB 厚度 (建议) | 1.57 mm[.76 in] |

使用环境

| | |
|---------|----------------------------|
| 壳体温度额定值 | 高 |
| 工作温度范围 | -65 – 125 °C[-85 – 257 °F] |

操作/应用

| | |
|--------|-----|
| 焊接工艺特性 | 板支座 |
|--------|-----|



| | |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

| | |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

| | |
|------|---|
| 封装数量 | 3 |
|------|---|

| | |
|------|------|
| 封装方法 | Tube |
|------|------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|--------------------|-----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 不符合 |
|--------------------|-----|

| | |
|-------------------|---------|
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合且适用豁免 |
|-------------------|---------|

| | |
|---|----------|
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值 |
|---|----------|

| | |
|-----------------------------|---|
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | <p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)</p> <p>超过限值的SVHC:</p> <p>Pb (13% in Component Part)</p> <p>物品安全使用说明: 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p> |
|-----------------------------|---|

| | |
|------|---|
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
|------|---|

| | |
|--------|----------|
| 焊接工艺能力 | 不能采用无铅工艺 |
|--------|----------|

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸

HDI PIN ASSY 3 ROW 165 POS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_532433-8_T.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_532433-8_T.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_532433-8_T.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1-1773957-5_AMP_HDI_BTБ_CONNECTORS_EN](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本